



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN22923X

Issue Date: 05 Dec 2019

Title of Change:	Base and Submodule Substrate Change and Max Height Change for R3910 and R3920.	
Proposed First Ship date:	30 Jun 2020 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Christophe.Waelchli@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Base substrate will change from white to a yellow/brown color. Affected products will be identified by workorder number.	
Change Category:	Assembly Change	
Change Sub-Category(s):	Material Change, Datasheet/Product Doc change	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
ON Semiconductor Burlington, Canada	None	
Description and Purpose:		
	Before Change Description	After Change Description
Base substrate	96% Al ₂ O ₃	BT resin based laminate
Submodule substrate	96% Al ₂ O ₃	BT resin based laminate
Max Body Height (Dim A2 in Datasheet)	1.651mm	1.499mm
Max Overall Height (Dim A in Datasheet)	1.829mm	1.651mm
There is no product marking change as a result of this change		

**Qualification Plan:**

QV DEVICE NAME: R3910-E1

RMS: 64409

PACKAGE: SiP-25

Test	Specification	Condition	Interval
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 4 @ 240°C	3x

QV DEVICE NAME: SB3229-E1

RMS: 64169

PACKAGE: SiP-25

Test	Specification	Condition	Interval
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	504 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +125°C	100 cyc
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 4 @ 240°C	3x

Estimated date for qualification completion: 24 March 2020

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
SA3400-E1-T	NA
R3910-CFAB-E1B	R3910-CFAB-E1B
R3910-CFAB-E1T	R3910-CFAB-E1B
R3920-CFAB-E1B	NA
R3920-CFAB-E1T	NA

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22923X

発行日: 05 Dec 2019

変更件名:	ベースとサブモジュール基板の変更および R3910 と R3920 の高さ寸法の変更	
初回出荷予定日:	30 June 2020 (またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前)	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Christophe.Waelchli@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。	
変更部品の識別:	ベース基板の色が白から黄色/茶色に変更されます。影響を受ける製品は、ワークオーダー番号によって識別されます。	
変更カテゴリ:	アセンブリの変更	
変更サブカテゴリ:	材料の変更, データシート/製品資料の変更	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
ON Semiconductor Burlington, Canada	なし	
説明および目的:		
	変更前の表記	変更後の表記
ベース基板	96% Al ₂ O ₃	BT resin based laminate
サブモジュール基板	96% Al ₂ O ₃	BT resin based laminate
本体の高さ寸法(データシート上の寸法 A2)	1.651mm	1.499mm
全体の高さ寸法(データシート上の寸法 A2)	1.829mm	1.651mm
今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。		



認定計画:

デバイス名: R3910-E1

RMS: 64409

パッケージ: SiP-25

テスト	規格	条件	間隔
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 4 @ 240°C	3x

デバイス名: SB3229-E1

RMS: 64169

パッケージ: SiP-25

テスト	規格	条件	間隔
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	504 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +125°C	100 cyc
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 4 @ 240°C	3x

認定完了予定日: 24 March 2020

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
SA3400-E1-T	NA
R3910-CFAB-E1B	R3910-CFAB-E1B
R3910-CFAB-E1T	R3910-CFAB-E1B
R3920-CFAB-E1B	NA
R3920-CFAB-E1T	NA